

关于原产地标签信息更新的通知

尊敬的客户：

近期，中国海关持续强化集成电路（税则号列 HS 8542）原产地申报监管，已将原产地查验及验估列为重点监管环节。为保障贵我双方合作中进出口业务合规顺畅，防范因原产地信息“单单不符”、“单货不符”引发的通关延误等风险，我司依据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国进出口货物原产地条例》等相关法律法规，现就集成电路产品原产地标签信息更新事宜告知如下：

海关监管背景与核心要求

当前全球集成电路产业链分工日益细化，各国非优惠原产地规则存在差异（我国海关以完成实质性改变的晶圆制造地（流片地）为核心判定标准），传统标注“COO”“Origin”“Made in”等笼统原产地信息的方式，已无法满足海关监管要求。

海关明确要求：原产地判定主要依据**原厂箱单、原厂发票及产品标签所载晶圆生产信息**（包括但不限于 COD、CCO、Diffusion/Diffused in、FAB 等）为核心依据，确保原产地信息与实际生产环节精准对应。

标签信息更新内容

从 2026 年 1 月起，我司所有供贵司的进出口产品标签信息将统一更新为：

- 取消“COO (Country of Origin)”标注，不再使用笼统原产地表述；
- 新增“COD (Country of Diffusion/FAB)”，填写晶圆生产地（流片地），需与原厂晶圆制造信息一致；
- 新增“COA (Country of Assembly)”，填写封装生产地，清晰区分晶圆制造与封装产地。

附则

本通知函未尽事宜，我们将依据国家海关及税务相关法律法规与贵司友好协商。感谢贵司的理解与支持，我们将持续以合规、高效的服务保障双方合作共赢。

特此告知。

美新半导体

2025 年 9 月 25 日